



「WBG 半導体のパワエレ応用」

◇ 日時： 2023年2月22日(水) 13:00~17:30

◇ 場所： 大阪大学吹田キャンパス 医学・銀杏会館 阪急・三和ホール
大阪府吹田市山田丘 2-1 大阪モノレール・彩都線「阪大病院前」駅下車 徒歩 5分
(会場アクセス図:別紙参照) <https://www.eng.osaka-u.ac.jp/ja/access/#c01>

パワーエレクトロニクス技術を支えるパワー半導体は長く、Si-MOSFETやIGBTが主役であった。近年、スマートフォンのACアダプタ等にGaN-HEMT、電気自動車、鉄道のインバータ等にSiC-MOSFETが適用されるに至っている。今後、これらの分野で広く適用され、新しい応用先の検討も始まっている。

本研究会では、ワイドバンドギャップ(WBG)半導体が適用されている分野からのご講演を頂戴し、今後の研究、開発に生かす。

..... プログラム

12:30 開場

13:00~13:10 開会の挨拶、本日の進行説明

13:10~13:45 EVの充放電規格とグローバル動向

-各国政策、市場、技術動向、グローバル競争

今津 知也 (CHAdeMO協議会、東京電力)

13:45~14:20 車載インバータに使われるパワーモジュールの現状と課題

神谷 有弘 ((株)デンソー)

14:20~14:55 GaN パワートランジスタのパワエレ応用

庄野 健 (トランスフォーム・ジャパン(株))

14:55~15:30 SiC パワーデバイスの鉄道車両適用現況と更なる主回路小型化への取組み

福田 典子 ((公財)鉄道総合技術研究所)

15:30~15:40

休憩

15:40~16:15 アークレス直流ハイブリッドスイッチの開発

川口 卓志 ((株)シグマエナジー)

16:15~16:50 パワーデバイスの進化とSiC 応用機器の動向

大井 健史 (三菱電機(株))

16:50~17:25 車載パワーエレクトロニクス市場について

保坂 透 (YOLE(株))

17:25~17:30 閉会の挨拶

■ 参加受付: WEB参加受付システム([ここ](#)をクリック)から参加登録と参加費のオンライン決済をお願いします。席数に限りがあるため早期に参加受付を終了することがあります。

■ 参加費: (消費税込み)

先進パワー半導体分科会会員* 4,000円、分科会学生会員 1,000円、一般 6,000円、一般学生 1,000円

*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■ 感染症対策: 事前の検温にご協力頂き、発熱がある場合は当日のご参加はご遠慮下さい。また、会場入り口での再度の検温にご協力下さい(体温が37.5度以上ある場合、ご参加頂けません)。会場では、消毒およびマスクの常時着用をお願い致します。

■ 問い合わせ先:

古川 彰彦(三菱電機)

e-mail: Furukawa.Akihiko@df.mitsubishielectric.co.jp

鎌田 功穂(電力中央研究所)

e-mail: kamata@criepi.denken.or.jp

田中 亮(富士電機)

e-mail: tanaka-ryou@fujielectric.com

別紙

